

● USP-8B06(DAF)パッケージ許容損失

USP-8B06(DAF)パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件 (参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：銅箔4層基板 76.2mm×114.3mm (片面約 8700mm²)

に対して銅箔面積

1層目：50mm×50mm_放熱板と接続有

2層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

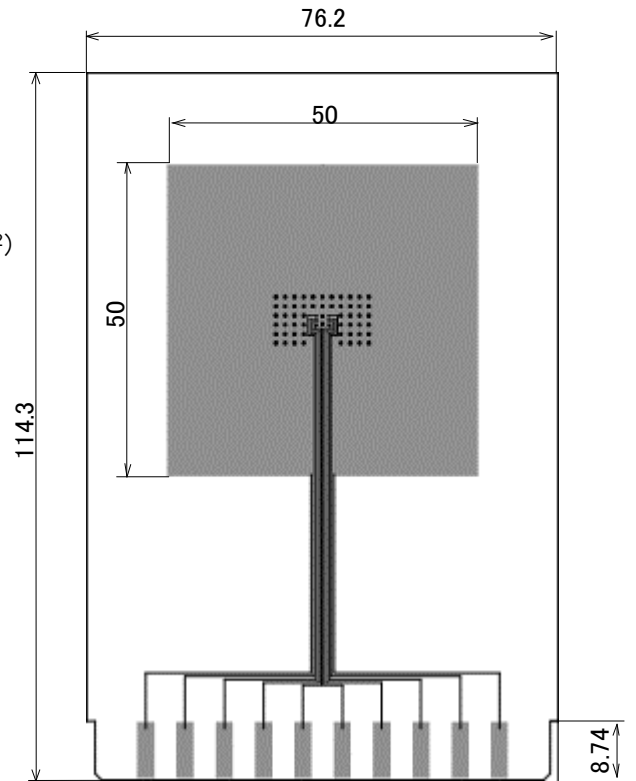
3層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

4層目：50mm×50mm_放熱板と接続有

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個

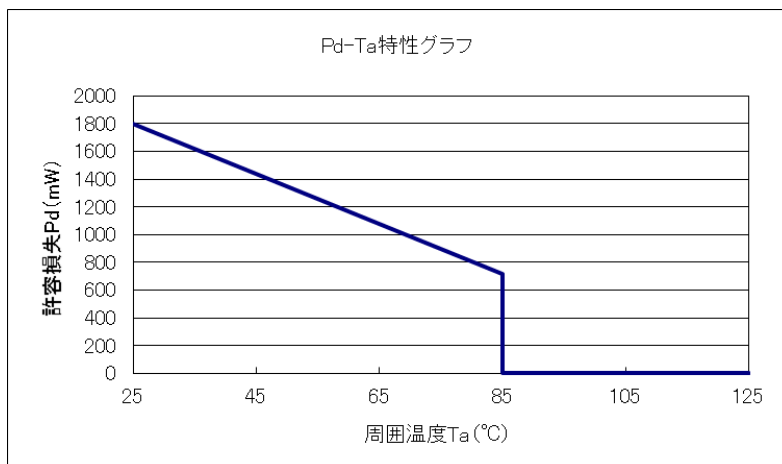


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	$\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$
25	1800	55.56
85	720	



● USP-8B06 パッケージ許容損失(JESD51-7)

USP-8B06 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件 (参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：4層基板 76.2mm × 114.3mm (片面約 8700mm²)

に対して銅箔面積

1層目：銅箔無し放熱板と周りの銅箔接続

2層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

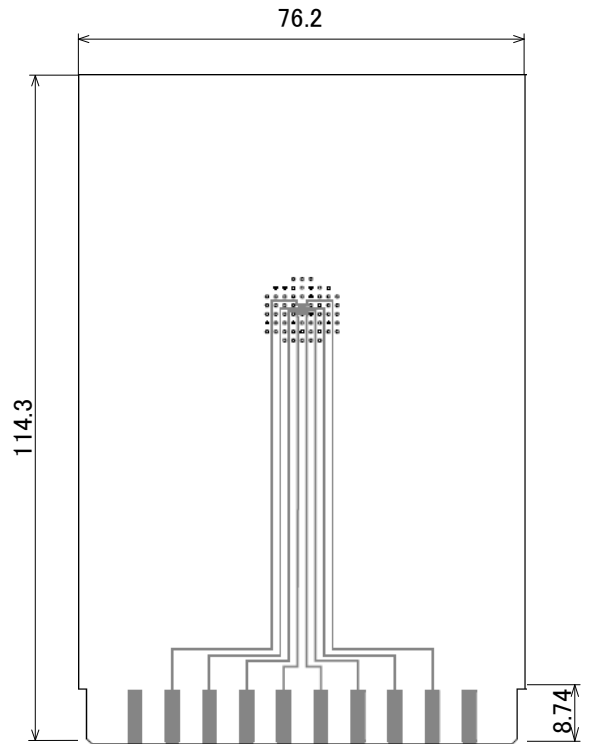
3層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

4層目：銅箔無し

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	$\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$
25	1240	80.65
105	248	

